

# 2012年3月期 決算説明会資料

2012年5月15日

 **ミツミ電機株式会社**



<b>2012年3月期通期 決算の概要</b>	<b>P2</b>
<b>2013年3月期 業績予測</b>	<b>P11</b>
<b>今後の経営戦略</b>	<b>P16</b>

**【免責事項】**

この資料は投資家の参考に資するため、ミツミ電機株式会社（以下、弊社）の現状を理解いただくことを目的として作成したものです。

当資料に記載された内容は、2012年5月15日現在において、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。投資に関するご決定は、当資料に全面的に依拠することはお控えいただき、皆様ご自身のご判断でなされるようお願い申し上げます。

# 2012年3月期通期 決算の概要

取締役 本社管理部門担当(兼)経理部統括部長

齋藤 求

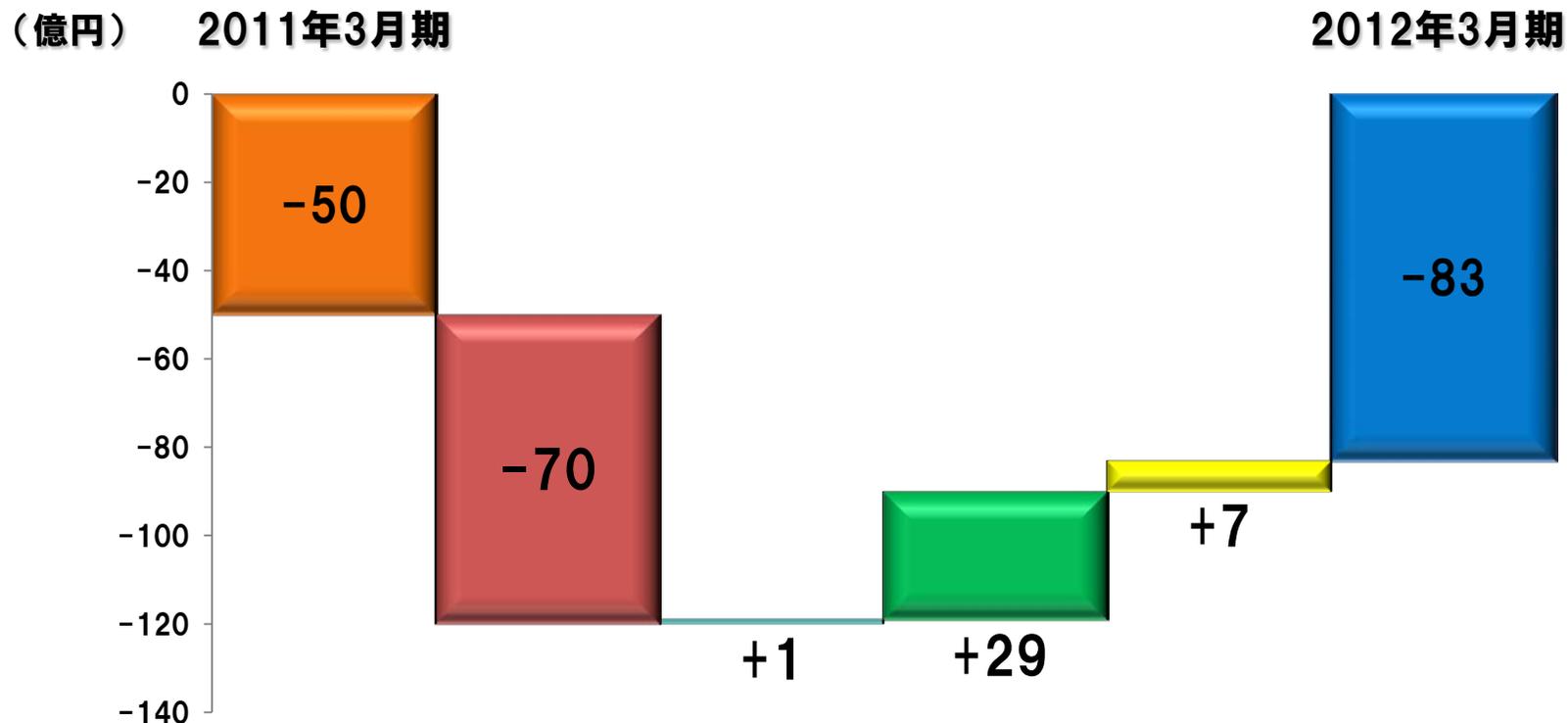
# 決算ハイライト



- ◆ 売上高は、アミューズメント関連製品と新携帯端末向け製品は前年並みで推移、全体では円高・価格下落を数量増加で補えず減少
- ◆ 利益は、売上高の減少により付加価値額が低下、減損損失127億円・退職加算金51億円を特別損失に計上、繰延税金資産19億円取り崩し

	2011年3月期		2012年3月期		増減
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)
売上高	187,418	100.0	167,207	100.0	△20,211
営業利益	△5,020	△2.7	△8,357	△5.0	△3,337
経常利益	△6,387	△3.4	△8,234	△4.9	△1,847
当期純利益	△3,541	△1.9	△28,335	△16.9	△24,794
為替レート (対米ドル)	86.04円		79.06円		6.98円の円高

# 営業利益増減分析



## ◆ 前年同期比 $\Delta$ 33億円

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| (1) 売上減(価格下落含む)・製品構成変化・為替変動等による付加価値減少 | -70億円 |
| (2) 素材価格の高騰と変動費改善の差額                  | +1億円  |
| (3) 減価償却費を除く固定費の削減による改善               | +29億円 |
| (4) 減価償却費の減少による費用減少                   | +7億円  |

# 収益力改善施策の進捗及び減損処理の状況



「緊急施策の実施と成長戦略についてのお知らせ」(2012年2月2日)より

## ① 退職金制度見直しに係る移行措置への応募結果

235名の応募があり、特別退職金39億円を特別損失に計上しました。2013年3月期の労務費は約21億円減少します。

## ② 投資及び一般経費の削減

投資については、期初計画85億円、削減後計画65億円に対して、顧客の要望を踏まえ、2013年上半期計画の投資14億円を前倒しし、79億円を実施いたしました。

一般経費については、計画通り約6億円を削減しました。

## ③ 減損処理

127億円の減損処理を行いました。2013年3月期の減価償却費は約30億円減少します。

## 製品集計区分別売上高



	2011年3月期		2012年3月期		対前年比増減		概要
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	%	
半導体デバイス	34,941	18.6	31,599	18.9	△3,342	△9.6	モジュール製品が減少
光デバイス	13,759	7.3	11,081	6.6	△2,678	△19.5	カメラモジュールは増加。 パソコン用ウェブカメラ は事業終息により減少
機構部品	83,523	44.6	80,256	48.0	△3,267	△3.9	アミューズメント関連は 前年並み 汎用製品が減少
高周波部品	30,978	16.5	23,942	14.3	△7,036	△22.7	モジュール製品が減少
電源部品	19,407	10.4	17,713	10.6	△1,694	△8.7	薄型TV・映像関連製 品が減少 他用途は前年並み
情報通信機器	4,808	2.6	2,614	1.6	△2,194	△45.6	不採算製品からの 継続的撤退
売上高合計	187,418	100.0	167,207	100.0	△20,211		

## 要約連結貸借対照表



(単位：百万円、%)

	2011年3月期末 (金額) (構成比)		2012年3月期末 (金額) (構成比)		増減金額
<b>資産の部</b>					
流動資産	143,800	75.0	121,889	79.8	△21,911
固定資産	48,026	25.0	30,771	20.2	△17,255
資産合計	191,827	100.0	152,660	100.0	△39,167
<b>負債の部</b>					
流動負債	50,243	26.2	41,859	27.4	△8,384
固定負債	1,924	1.0	1,712	1.1	△212
負債合計	52,167	27.2	43,572	28.5	△8,595
<b>純資産の部</b>					
株主資本	155,214	80.9	125,128	82.0	△30,086
評価・換算差額等	△15,554	△8.1	△16,041	△10.5	△487
純資産合計	139,659	72.8	109,087	71.5	△30,572
負債純資産合計	191,827	100.0	152,660	100.0	△39,167
自己資本比率	72.8%	—	71.5%	—	△1.3%

## 要約連結キャッシュ・フロー計算書



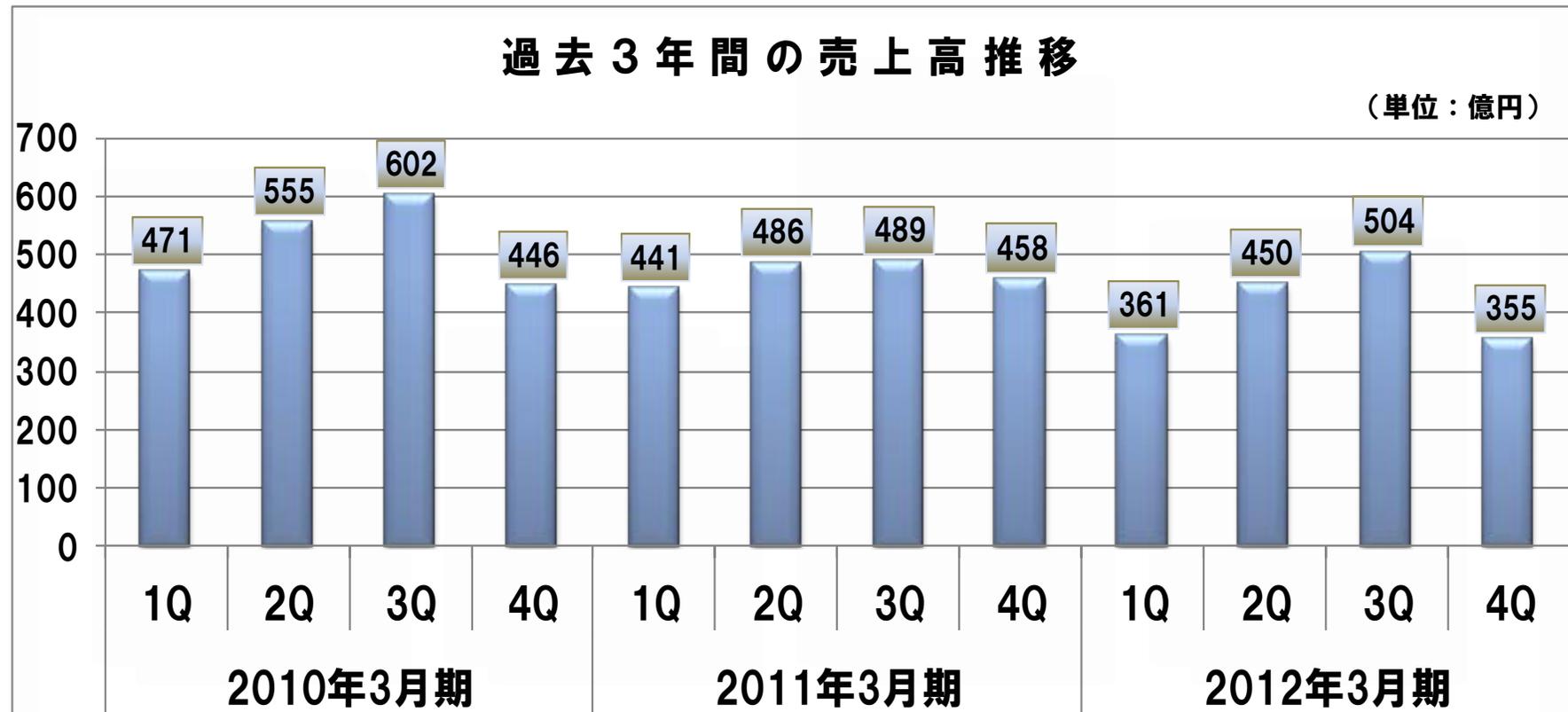
(単位：百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	概要
営業活動による キャッシュ・フロー	5,457	22,488	売上債権:23,001減少 たな卸資産:9,559減少 仕入債務:12,770減少
投資活動による キャッシュ・フロー (有形固定資産取得)	△13,963 (△13,269)	△7,062 (△7,737)	設備投資を削減
フリーキャッシュ・フロー	△8,506	15,426	
財務活動による キャッシュ・フロー	△3,062	△1,752	配当
現金及び現金同等物の 増減額	△12,452	13,541	
現金及び現金同等物の 期末残高	43,417	56,959	

# 四半期毎売上高の推移



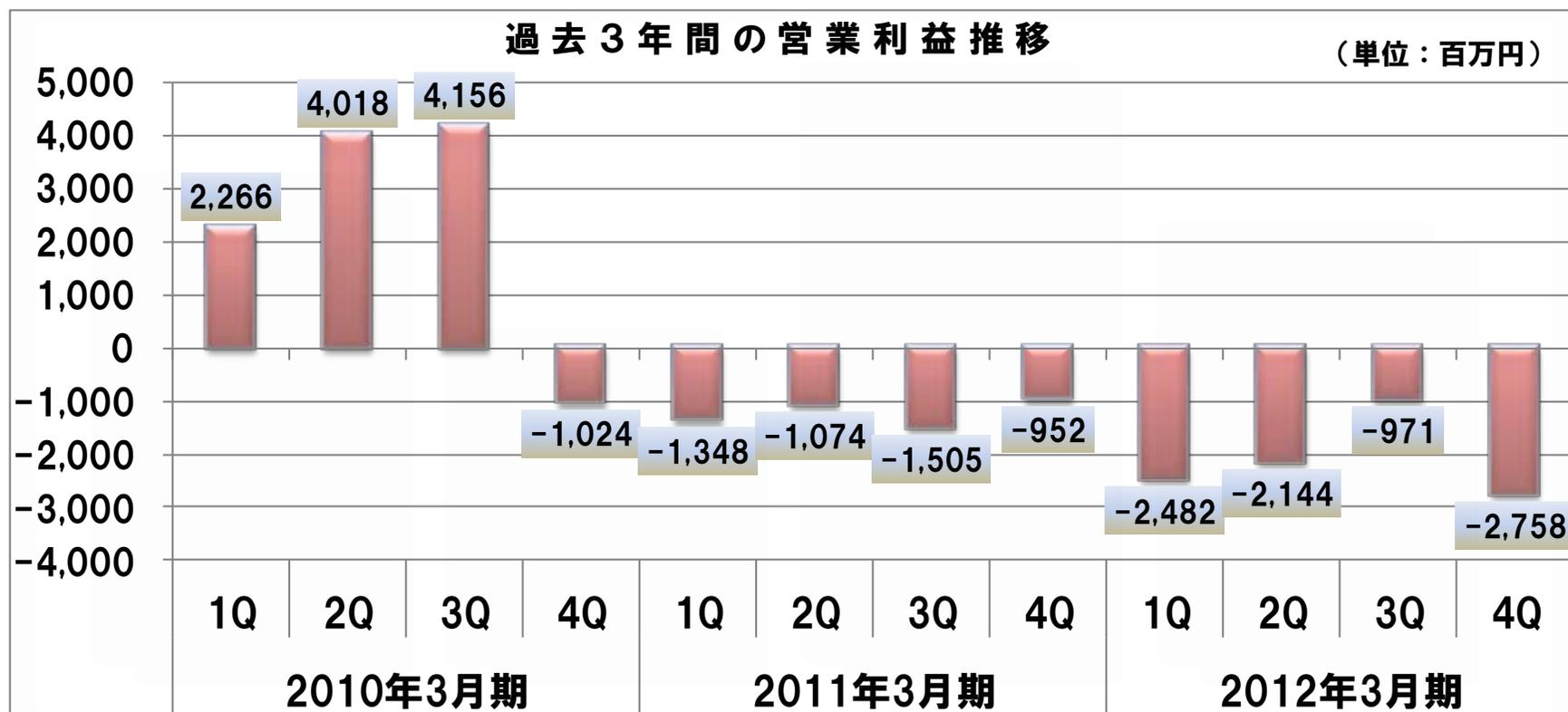
- ◆ 外部要因として、価格下落の継続（円高進行）、顧客の寡占化、EMSによる部品内製化、短納期化によるシーズナリティの拡大
- ◆ 内部要因として、新興国市場の開拓遅れ（新興国市場での顧客サービス体制構築の遅れ）、新携帯端末関連事業の拡大に遅れ



# 四半期毎営業利益の推移



- ◆ 原因として、売上高減少による付加価値額の減少、原材料価格の高騰、中国を中心とした生産拠点での事業運営コストの上昇



# 2013年3月期 業績予測

取締役 本社管理部門担当(兼)経理部統括部長

齋藤 求

## 2013年3月期 通期業績見通し(前年同期比較)



- ◆ 上半期の損失を最小限に留め、下半期および通期の黒字化を達成する
- ◆ 主要顧客の増産に対応して生産能力を拡大し、下半期での売上高回復を実現する（新携帯端末やアミューズメント関連製品を中心に拡大）

	2012年3月期		2013年3月期（予測）		増減
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)
売上高	167,207	100.0	180,000	100.0	12,793
営業利益	△8,357	△5.0	2,000	1.1	10,357
経常利益	△8,234	△4.9	1,500	0.8	9,734
当期純利益	△28,335	△16.9	1,000	0.6	29,335
為替レート (対米ドル)	79.06円		80.00円		0.94円の円安

## 2013年3月期 半期業績見通し(上下期比較)



- ◆ 売上高：下半期は上半期比400億円増加（下半期は新製品の増産を計画）
- ◆ 各段階利益：下半期は、上半期に対して75～80億円改善

	2013年3月期 上半期予測		2013年3月期 下半期予測		上半期/下半期の増減	
	金額(百万円)	売上高比(%)	金額(百万円)	売上高比(%)	下半期－上半期 金額(百万円)	下半期/上半期 変化率(%)
売上高	70,000	100.0	110,000	100.0	+40,000	157.0
営業利益	△3,000	△4.3	5,000	4.3	+8,000	—
経常利益	△3,000	△4.3	4,500	4.1	+7,500	—
当期純利益	△3,500	△5.0	4,500	4.1	+8,000	—
為替レート (対米ドル)	80.00円		80.00円			

# 設備投資・減価償却費・研究開発費

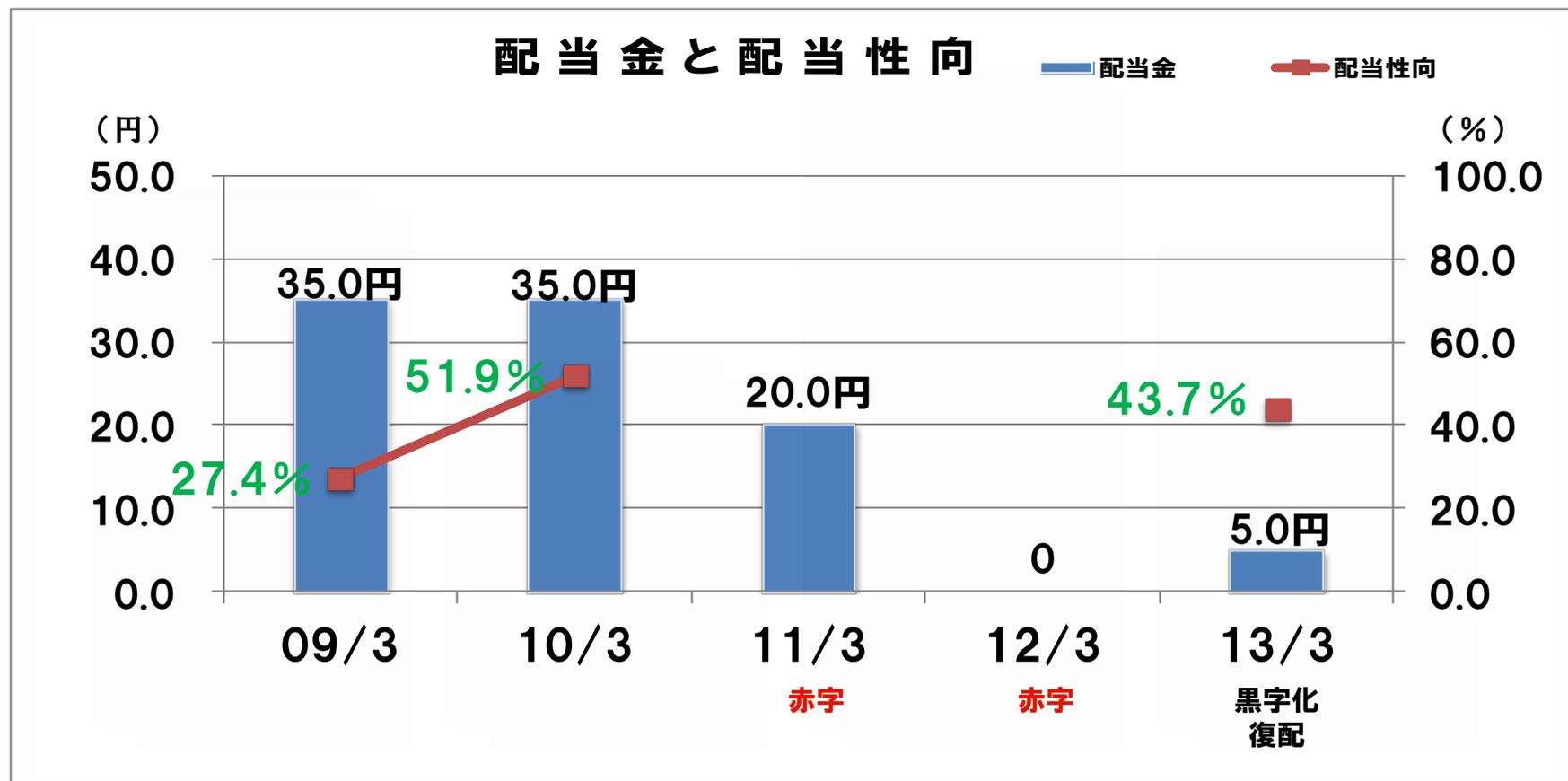


- ◆ 設備投資：直近の売上高拡大と事業再編の投資が中心
- ◆ 研究開発費：新情報端末・車載エネルギー関連事業に集中

	2012年3月期実績		2013年3月期予測		増減	
	金額(百万円) 下段 上半期実績	売上高比 (%)	金額(百万円) 下段 上半期予測	売上高比 (%)	金額(百万円)	変化率 (%)
設備投資	7,954 (4,212)	4.8	10,000 (8,000)	5.6	2,046	25.7
減価償却費	10,299 (5,652)	6.2	9,000 (3,800)	5.0	△1,299	△12.6
研究開発費	12,918 (6,507)	7.7	12,000 (5,300)	6.1	△918	△6.7



## ◆ 2013年3月期の黒字化による復配(5円)を計画



# 今後の経営戦略

代表取締役社長  
森部 茂



## 2013年3月期におけるエレクトロニクス市場の見通し

欧州債務問題などの不安要因はあるものの、スマートフォンなどの情報通信端末の伸張、新興国での堅調な需要によって、数量ベースで大幅拡大、金額ベースで微増を維持するものと考えます。

特に車載部品については、数量・金額共に市場拡大が継続するものと考えます。

### 電子部品市場の中期トレンド

中期トレンドに  
大きな変更はありません。

- ・ エレクトロニクス市場での寡占化の進行により上位顧客(EMS顧客)や新興国顧客が市場全体を牽引し、継続的に拡大します。
- ・ 新興国競合企業の台頭、EMS企業の部品内製化等により、価格競争が更に激化します。
- ・ 中国の事業運営コスト高騰が継続します。



## 目 標

売上高3,000億円を回復する

## 方 針

### (1) コア技術の深掘りにより競争優位を高める

- \* 機構部品・電源部品・光デバイスを拡大強化します。
- \* 半導体デバイスと高周波部品は、現時点で競争力を維持している製品市場に絞り込み、事業を再建します。
- \* 絞り込んだ市場で占有率を更に高めて、経営基盤を強化します。

### (2) 総合電子部品メーカーとして事業の相乗効果を高める

- \* 部品・モジュール事業を強化します。
- \* 内製部品・モジュール部品の活用により、セット事業を拡大します。

### (3) 世界の成長企業への売上を拡大する



# 市場別説明

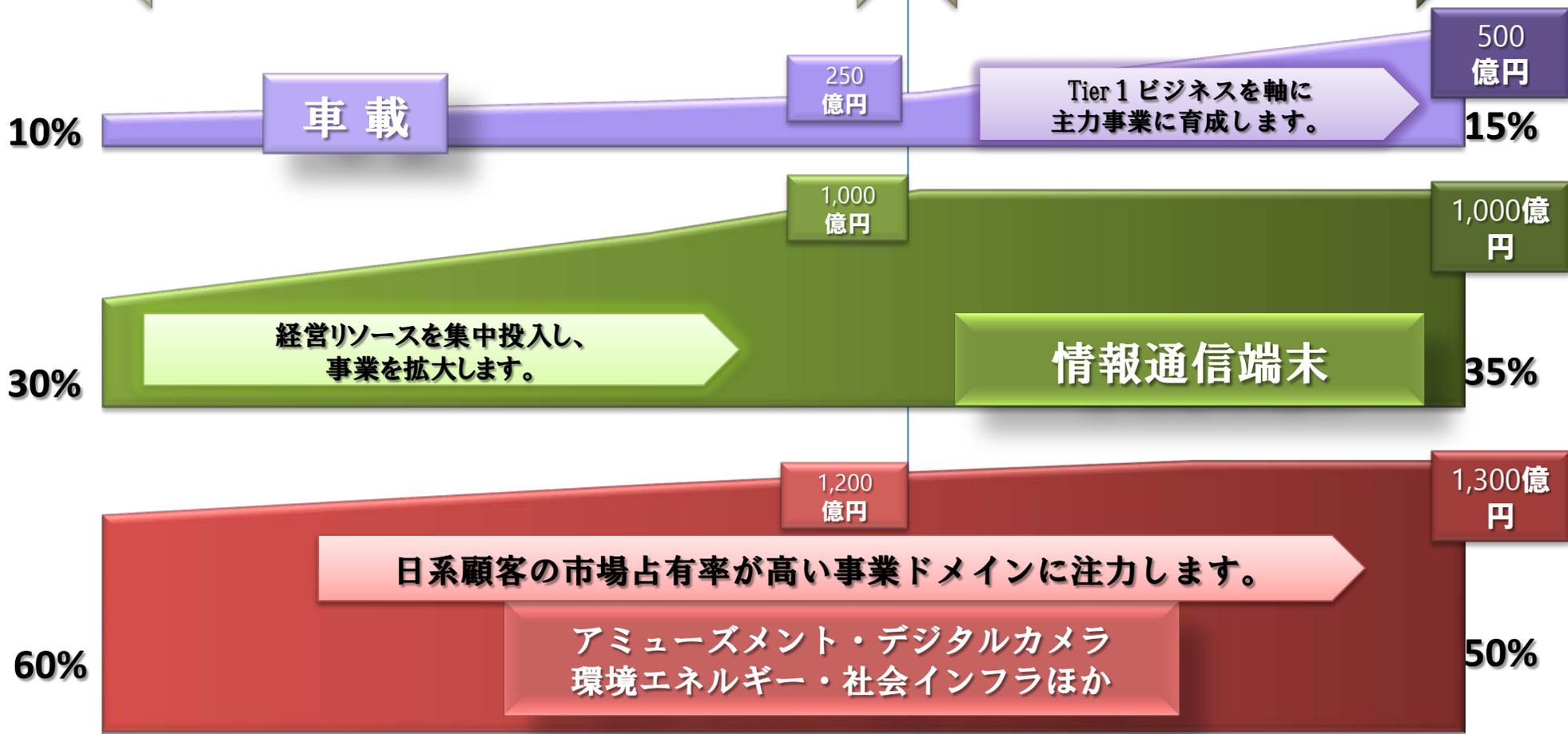
# 市場別売上目標



2012年  
3月

STEP 1 (~3年目)

STEP 2 (4年目以降)



# 市場別取り組み ①



## 車 載

電子機器化が加速する自動車市場に家電・情報端末市場で実績のある製品を投入し、事業拡大を実現します。

- アンテナ製品を中心とした Tier1事業、車載カメラ・無線モジュールを中心とした Tier2事業を拡大いたします。
- 総合電子部品メーカーとして、複数製品のユニット化を提案して行きます。
- 電池関連半導体の市場参入を検討しています。

### 光デバイス:

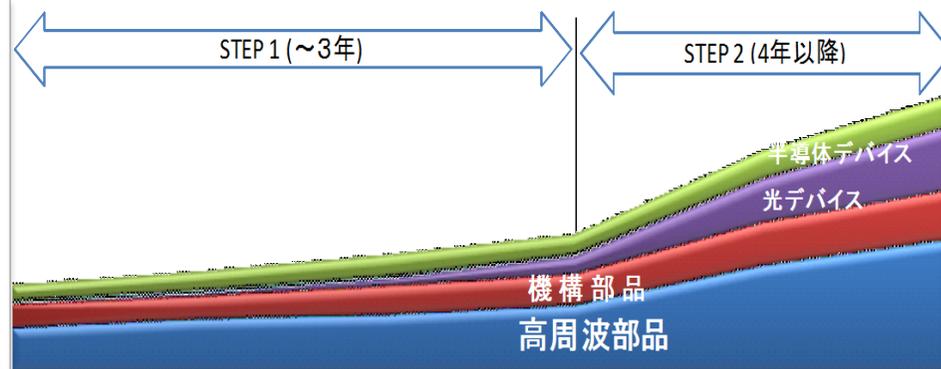
車載カメラ(米国KT法施行)ほか

### 機構部品:

高速伝送コネクタ、車載用インダクタ

### 高周波部品:

GPS・複合アンテナ、車載デジタルチューナ  
無線モジュール各種



# 市場別取り組み ②

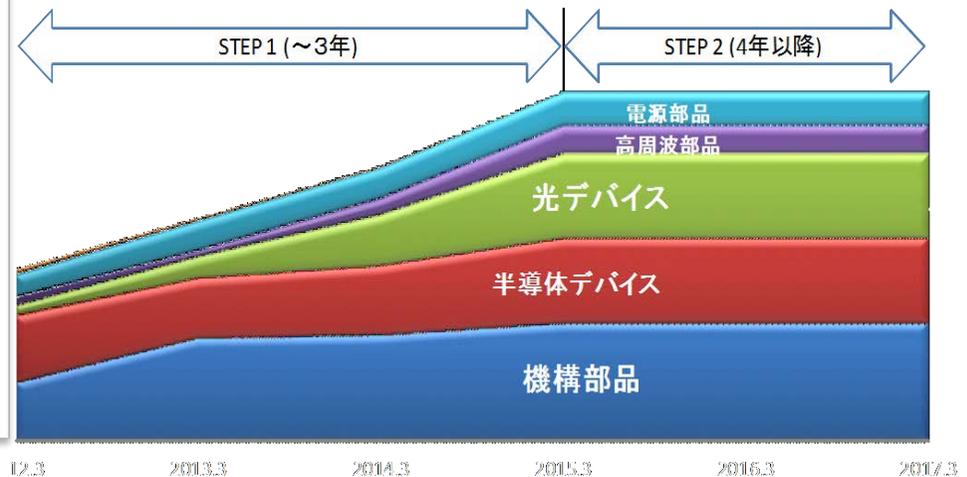


## 情報通信端末

**スマートフォン・タブレットPC向け部品事業に経営資源を集中的に投入し、事業拡大と収益性の回復を達成します。**

情報通信端末用途での当社部品採用実績が増え、市場の信頼を勝ち取っています。機構部品・光デバイス事業の市場占有率を更に高めるとともに、半導体事業もこの事業ドメインに集中します。

- 電源部品：**  
ACアダプタ
- 光デバイス：**  
高画素カメラモジュール
- 半導体デバイス：**  
電池保護用IC、電池保護用モジュール
- 機構部品：**  
小型カメラ用アクチュエータ、  
スイッチ、カードコネクタなど



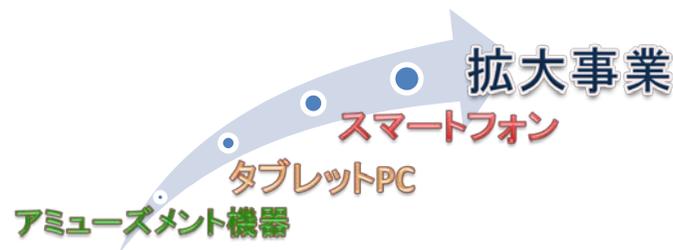


# 事業別説明

# 事業別取り組み ①



## 機構部品



機構部品は、スマートフォン・タブレットPC・アミューズメント向けに精密加工・精密金型・精密組立技術の継続的強化を行っており、最も競争力が高い事業です。

今期はこの製品事業の生産能力を倍増し、下半期の売上拡大に結びつけます。さらに特長ある精密部品との相乗効果で、セット製品においても事業を拡大します。

### [ 精密部品 ]

高画素対応アクチュエータ、手ぶれ補正アクチュエータ、スイッチ、カードコネクタ、車載用高速伝送コネクタ、事務機用モータ、情報端末・車載用インダクタ

### [ セット製品 ]

アミューズメント関連製品



## 高周波部品



### ① 拡大分野

#### 車載・エネルギー関連

Tier1ビジネスを活用し、車載事業を拡大します。  
通信モジュールをスマートグリッド関連市場に投入します。

#### アミューズメント・情報通信端末関連

常に最先端の無線モジュール製品を開発し、事業を拡大します。

#### IP通信関連

放送・通信市場での実績と蓄積技術で、IP-STBを拡販します。

### ② 縮小分野

#### 車載用以外のチューナ関連

チューナ事業は車載衛星放送ラジオなどの高付加価値製品に特化します。また、再編に伴って経営リソースを成長分野にシフトします。



## 半導体デバイス



### ① 自社設計半導体事業

- ・ 高精度アナログをコアとした高機能製品の開発を強化します。  
特に優位性を持つ2次電池制御半導体で市場占有率を高めます。
- ・ 社外FABを最大限に活用し、顧客訴求力のある製品を短期間で製品化して、市場投入します。

### ② ファンドリ事業

- ・ 千歳事業所を中心に競争力を一層強化し、主力事業に育成します。

### ③ 生産体制の見直し

- ・ 厚木事業所の5インチラインは2012年3月末で終息しました。  
5インチ製品は6インチラインで継続生産しています。
- ・ 更なる生産効率の向上を目指すため、今後2年を目処に、  
前工程・後工程の生産体制の最適化を実施します。



事業運営体制の強化



## 海外の機能強化

### ① 生産管理機能

納期回答・資材調達・生産計画・人員採用などの日々の生産に関わる全ての管理機能を、段階的に海外工場に移管します。

### ② 設計・生産技術機能

製品設計・生産技術機能を移植し、国内拠点技術部門との分業体制を構築します。

### ③ 顧客サービス

世界中の顧客に直接、海外拠点がサービスを行う体制を構築します。



## 生産拠点の競争力強化

### ① 中国からフィリピンへ生産移管

- ・ 中国は中国生産にメリットのある製品に集中します。  
主力であるフィリピン2工場(セブ・バターン)に、中国4工場の生産製品を移管し、コスト競争力の強化を行います。
- ・ 中国では設計技術・自動化技術の蓄積で、高付加価値事業を展開します。

### ② 中国内で事業拠点を再編

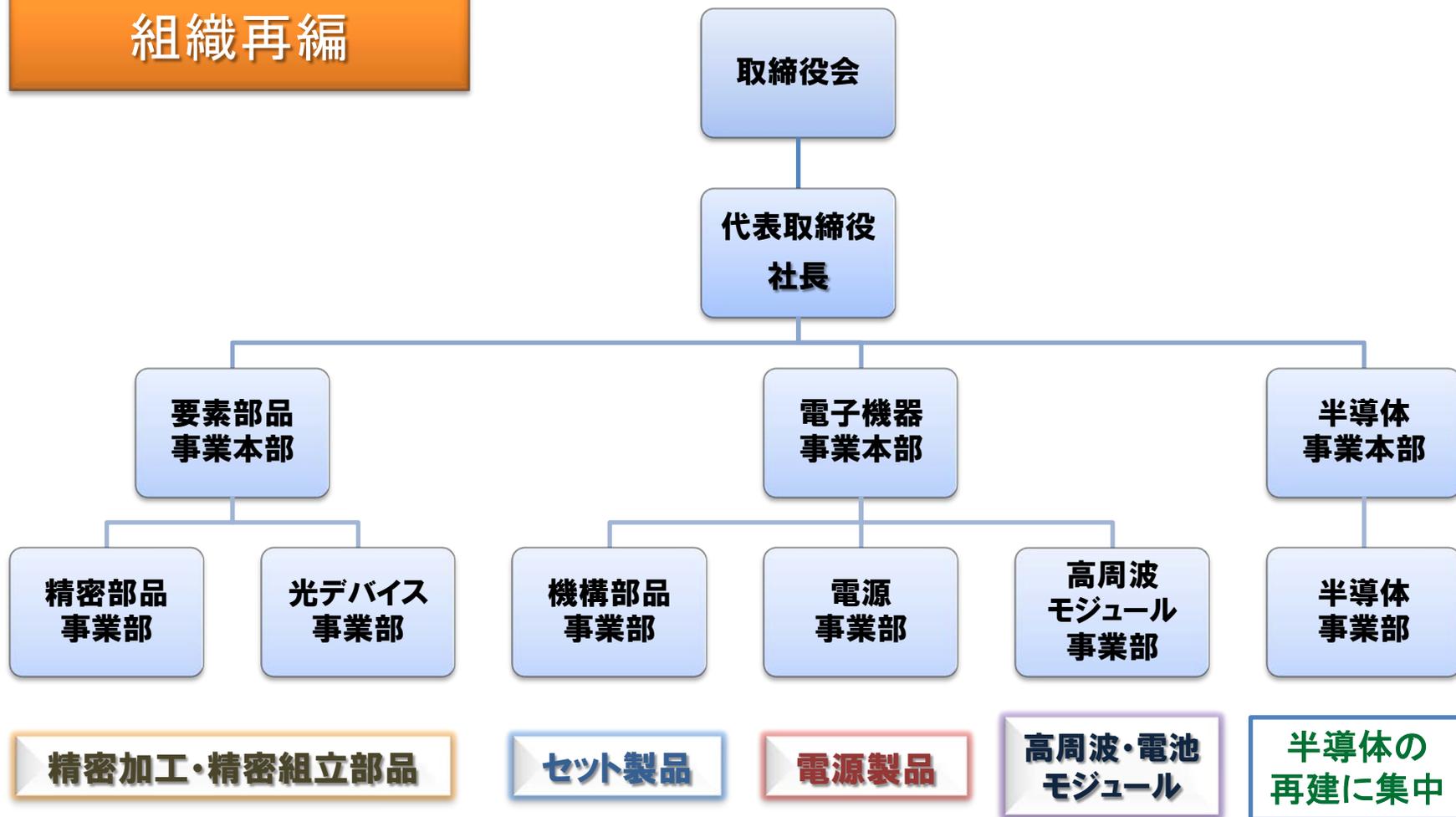
- ・ フィリピンへの生産移管で失われるスケールメリット対策。
- ・ 新工場の建設。  
中国地区で当社最大規模の新工場を青島市輸出加工区に建設中です。  
この工場を中心に、中国生産の再編を行います。



# 事業運営体制の強化 ③



## 組織再編





**IRに関する問い合わせ先**

**ミツミ電機株式会社  
総務部 広報・IRグループ**

**TEL:042-310-5224**

**FAX:042-310-5168**

**Mail :prwmaster@mitsumi.co.jp**